

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 9 月 17 日 (2009.9.17)

【公開番号】特開 2009-44065 (P2009-44065A)

【公開日】平成 21 年 2 月 26 日 (2009.2.26)

【年通号数】公開・登録公報 2009-008

【出願番号】特願 2007-209696 (P2007-209696)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/09 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 L 25/065 (2006.01)

H 0 1 L 25/07 (2006.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

H 0 5 K 1/11 (2006.01)

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/09 A

H 0 1 L 21/88 M

H 0 1 L 21/88 J

H 0 1 L 25/08 Z

H 0 5 K 1/11 N

H 0 1 L 23/12 N

H 0 1 B 13/00 5 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 7 月 31 日 (2009.7.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

50wt%以上のビスマス(Bi)と、30wt%以下のインジウム(In)と、30wt%以下の錫(Sn)と、1～5wt%の範囲で選択された銅(Cu)とからなる粉体混合物である、

基板配線用の導電性組成物。

【請求項 2】

基板に設けられた孔を埋める電極を有する回路基板であって、前記電極は、請求項 1 に記載された導電性組成物を用いて得られたものである、回路基板。

【請求項 3】

基板に設けられた孔を埋める電極と、回路パターンとを有する回路基板であって、前記電極は、請求項 1 に記載された導電性組成物を用いて得られたものであり、前記回路パターンは、前記電極と同一の導電性組成物で前記基板の少なくとも一面上に、前記電極と連続して同体に形成されたものである、回路基板。

【請求項 4】

請求項 2 又は 3 に記載された回路基板であって、前記基板は複数で、それぞれの基板は順次に積層されており、そのうちの少なくとも 1 層は、前記回路パターン及び前記電極を含んでいる、回路基板。

【請求項 5】

回路基板と、回路機能部とを有する電子デバイスであって、
前記回路基板は、請求項 2 乃至 4 の何れかに記載されたものであり、
前記回路機能部は、前記回路基板と組み合わされている、
電子デバイス。

【請求項 6】

請求項 5 に記載された電子デバイスであって、センサーモジュール、光電気モジュール、FET、MOS - FET、CMOS - FET、メモリーセル、FC (Field Complementary) もしくは集積回路素子又はこれらのチップである、電子デバイス。